

**Bâtis de dépôt : technologie, utilisation et maintenance 1<sup>er</sup> niveau****Réf. MS134 27 heures****OBJECTIFS DE FORMATION**

Identifier les parties de l'équipement  
Comprendre les principes généraux d'un équipement de dépôt ( exemple : par pulvérisation cathodique)  
Comprendre la technique de dépôt (*Sputtering* PVC, PVD...)  
Avoir une uniformité de dépôt  
Eviter les erreurs lors de dépôt afin d'éviter les rebus.  
Contrôler les différents paramètres intervenant lors du dépôt  
Surveiller afin de garantir que vos équipements restent à un niveau de performance optimum

Cette formation apportera les connaissances et les pratiques nécessaires aux techniciens pour :  
Fiabiliser des équipements.  
Améliore l'autonomie en production (recettes/dépôt)

**PUBLIC CONCERNE**

Opérateurs et techniciens de production et de maintenance

**PRE – REQUIS**

Expérience industrielle ; nous consulter pour définir le besoin

**INNOVATION PEDAGOGIQUE**

Partie sur site client :  
75 % de pratique, démonstrations et exercices d'application.  
Nous consulter pour adapter le programme à votre équipement de dépôt.  
AFEST : Action de Formation En Situation de Travail  
Pré-audit stagiaire pour préciser le besoin.  
Activités e-learning de démarrage, avant la formation avec le formateur

**FORMATEURS PRINCIPAUX**

Jean -Rémy BODIN : ingénieur de maintenance spécialisé en microélectronique (dépôt, gravure,...) depuis plus de 30 ans, qualifié Formateur.

**DATE & LIEU**

Réalisable sur site client pour une formation spécifique à votre entreprise.  
Sessions limitées à 4 participants.

**PRIX**

Sur devis pour une formation spécifique à votre entreprise

**PROGRAMME****Activités individuelles de démarrage en e-learning – 2-3 heures**

Révision sur les technologies du vide

**1. Technologie et fonctionnement des équipements de dépôt par pulvérisation cathodique**

Description de l'équipement et des technologies utilisées

- Comprendre toutes les phases pour entrer et sortir un support (substrat) dans une chambre de procédés sous vide

- Plasma : principes physiques de la nature du plasma, rôle du plasma dans le procédé de dépôt.

Vue d'ensemble du système

Votre système

Description

Paramètres de l'automate

**2. Description de la procédure d'utilisation**

Lancement d'une recette

**2.1 Le plasma**

Généralités sur les plasmas

**2.2 Les gaz utilisés**

La régulation du gaz : le MFC

**2.3 Le vide**

Capacités de pompage et étanchéité vide limite

TP : le test de fuite étanchéité

**2.4 La RF**

- Principe appliqués

- Les moyens et les principes de mesures de puissance

**3. Synthèse**

Le plasma :

Consolidation des compétences acquises pendant les 2 premières journées

Contrôles :

Mécanique : contrôle du vide

Electrique : isolation

Propreté de la chambre : procédure à suivre

Diagnostic de dysfonctionnement

Ecran de commandes – liste des défauts récurrents à la machine

**5. Travaux pratiques en situation**

Manipulation sur équipement du client

Identification des différents éléments sur le bâti

Mise en pratique : prise en main de l'équipement en autonome et mise en situation de recherche des éléments de l'équipement : arborescence, paramètres de l'équipement

Test de fuite, méthodologie hélium

**6. Débat et échange ouvert autour des situations vécues par le stagiaire**